

開示の要約

基板処理方法および基板処理装置

- 5 溶存酸素濃度を低減した液体を基板上に供給することで、基板表面の導電性材料の腐食を抑制することができる基板処理方法が開示される。基板処理方法は、不活性ガスを飽和溶解度以上に液体に溶解させることで、液体中に溶存する酸素を不活性ガスで置換し、不活性ガスが溶解した液体を減圧することで、液体中に不活性ガスの気泡を発生させ、気泡を含む液体を基板の表面に供給しながら基板を処理する。

10

図 1